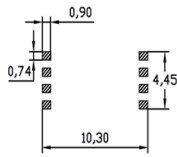


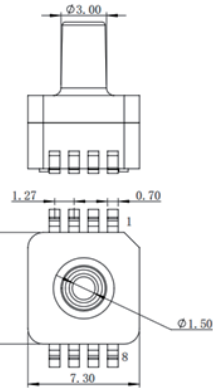
压阻式压力芯片 TYZV33-350-000-002



Model: TYZV33-002



焊盘尺寸 (Unit: mm)

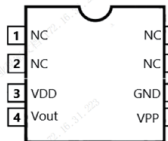


Size (Unit: mm)

产品特性

- 自带校准及温度补偿
- 模拟输出
- 表贴SOP8封装，绝压型
- 用于车载气泵、刹车助力等汽车电子领域

引脚定义



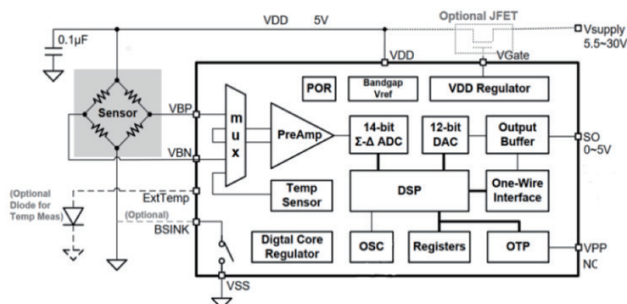
引脚号	符号	定义
1	NC	空
2	NC	空
3	VDD	输入电压
4	Vout	信号输出端
5	VPP	烧录端 (需悬空)
6	GND	接地端
7	NC	空
8	NC	空

压力芯片特性	工作压力	总误差带 ¹	长期稳定性 ²	温度补偿	封装形式
TYZV33-350-000-002	10~350kPa 绝压型	±2%FS	±0.35%FS	-10°C~85°C	单端垂直

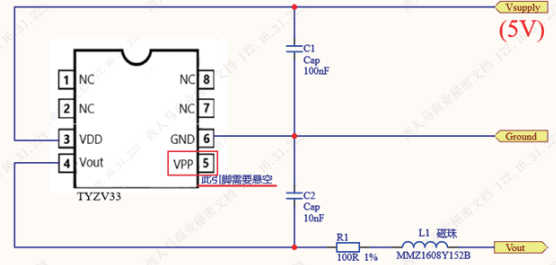
1. 总误差带包括零位、量程、压力非线性、压力迟滞、重复性、热零点偏移、热量程偏移和热迟滞造成的偏差。
2. 长期稳定性在25°C下HTOL测试1000小时。

性能		TYZV33-350-000-002	
线性度		±0.3%FS	
迟滞		±0.3%FS	
重复性		±0.3%FS	
过载压力		2x	
爆破压力		3x	
工作温度		-30℃~125℃	
存储温度		-40~125℃	
工作介质		无腐蚀性气体	
电气	最小	典型	最大
供电电压		5VDC	
零位输出	0.4V	0.5V	0.6V
满量程输出	4.4V	4.5V	4.6V
最大耐压		5.5V	
工作电流@25℃		1.2mA	1.8 mA
滤波电容		100nF	
输出最小阻抗	5Kohm		
输出电流负载			2.2 mA

惠斯通电桥的芯片信号经过低噪声的前置放大器(PreAmp)放大后,由Σ-ΔDAC转换为14-bit数字信号,然后经过数字信号处理电路(DSP)进行非线性校正和温度补偿,经过12bitDAC处理后输出模拟信号。



典型应用电路



注意: 焊接过程做好防静电保护;
请在VDD和GND之间加上100nF电容。